264 半導體元件物理與製程——理論與實務

為解決不完全空乏 floating body 造成的 kink effect 及 self heating 問題,可以 design 方式,將通道下中性區(neutrel regin)的載子藉由基材 pick up 將載子導出。

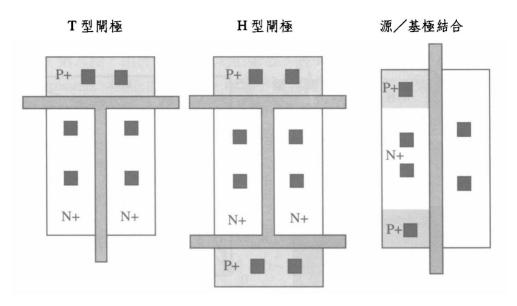


圖 8-6 基材 pick up 將電荷載子導出。

8.2.4 SOI 的工程問題

除了上節提到的 floating body 造成的 Kink 電性問題外,PD SOI 元件事實上短通道效應不佳,若 Si 厚度超過某一厚度時,這 Si 就與 Bulk 一樣,但其短通道效應會比 Bulk 的短通道效應差,因為 SOI 元件底下是氧化層,只留下通道,為了增加次臨界區的斜率會,通道掺雜降低,所以當汲極的電場更容易把 PD-SOI 通道下的掺雜空乏掉,短通道效應就比較嚴重。直到 SOI 的矽層厚度薄到 FD-SOI,源極及汲極的接面變得非常淺,因此短通道效應才又好起來。然後是 Self Heating 效應,氧化物 SiO₂ 的熱導是 Si 的 1%,所以 4000Å 的 SiO₂ 等於 40μ m Si 的熱阻,因此導熱上有些困難。通常我們量 SOI 元件時,經常在高電流時,I_D-V_D 曲線有點不太正常,本來應該是平行的,但它有點往下低。主要原因是在高壓時,Self Heating 造成電子遷移率降低,所以 SOI 元件經常會看到電